



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102768952 B

(45) 授权公告日 2014. 12. 17

(21) 申请号 201210271684. X

第3行至第3页第18行.

(22) 申请日 2012. 08. 01

CN 102163549 A, 2011. 08. 24, 全文.

(73) 专利权人 宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司

US 2007/0042567 A1, 2007. 02. 22, 全文.

地址 315177 浙江省宁波市鄞州区望春工业
园区杉杉路 181 号

审查员 纪金国

(72) 发明人 吴艳芬 詹国平 陈筑 刘晓巍
刘伟 徐晓群

(74) 专利代理机构 宁波市鄞州甬致专利代理事
务所(普通合伙) 33228

代理人 代忠炯

(51) Int. Cl.

H01L 21/306 (2006. 01)

(56) 对比文件

CN 102343352 A, 2012. 02. 08, 说明书第
[0004]~[0006] 段、[0036]~[0040] 段.

CN 101217173 A, 2008. 07. 09, 说明书第 2 页

权利要求书1页 说明书3页 附图1页

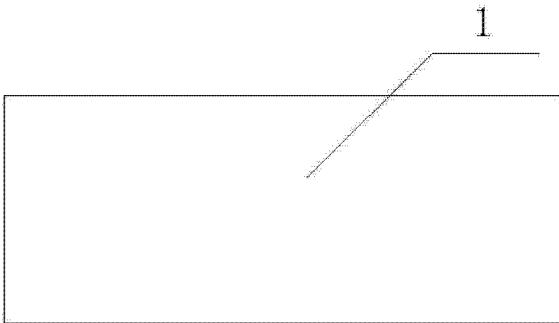
(54) 发明名称

扩散后单晶硅片次品返工方法

(57) 摘要

本发明公开一种扩散后单晶硅片次品返工方
法,包括以下步骤:将扩散后的次品放入氢氟酸
溶液中浸泡 4 ~ 10min,去除扩散过程中形成
的磷硅玻璃层,其中氢氟酸溶液中氢氟酸与水的
体积比为 1:4 ~ 10;用去离子水清洗,去除硅片表
面残留的氢氟酸;然后放入热的 NaOH 溶液中浸泡
2min ~ 5min,以去除硅的表面扩散层,其中 NaOH
溶液的质量浓度为 2% ~ 10%,NaOH 溶液的温度为
60°C ~ 80°C;再用 H₂O₂溶液将硅片清洗干净,H₂O₂
溶液中 H₂O₂与水的体积比为 1:4 ~ 10。本发明具
有能降低生产成本,提高电池合格率的优点。

B



1. 一种扩散后单晶硅片次品返工方法,其特征在于:包括以下步骤:(1) 将扩散后的次品放入氢氟酸溶液中浸泡4~10min,去除扩散过程中形成的磷硅玻璃层,其中氢氟酸溶液中氢氟酸与水的体积比为1:4~10;(2) 将步骤(1)浸泡后的硅片用去离子水清洗,去除硅片表面残留的氢氟酸;(3) 将步骤(2)清洗后的硅片放入NaOH溶液中浸泡2min~5min,其中NaOH溶液的质量百分比浓度为2%~10%,NaOH溶液的温度为60℃~80℃,以去除硅的表面扩散层;(4) 将步骤(3)浸泡后的硅片用H₂O₂溶液将硅片清洗干净,H₂O₂溶液中H₂O₂与水的体积比为1:4~10。
2. 根据权利要求1所述的扩散后单晶硅片次品返工方法,其特征在于:步骤(1)中氢氟酸与水的体积比为1:5。
3. 根据权利要求1所述的扩散后单晶硅片次品返工方法,其特征在于:步骤(1)中的浸泡时间为6min。
4. 根据权利要求1所述的扩散后单晶硅片次品返工方法,其特征在于:步骤(3)中NaOH溶液的质量浓度为5%。
5. 根据权利要求1所述的扩散后单晶硅片次品返工方法,其特征在于:步骤(3)中NaOH溶液的温度为80℃。
6. 根据权利要求1所述的扩散后单晶硅片次品返工方法,其特征在于:步骤(3)中浸泡时间为2.5min。
7. 根据权利要求1所述的扩散后单晶硅片次品返工方法,其特征在于:步骤(4)中的H₂O₂与水的体积比为1:6。

扩散后单晶硅片次品返工方法

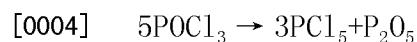
技术领域：

[0001] 本发明属于晶体硅太阳能电池制作领域，具体为一种扩散后单晶硅片次品返工方法。

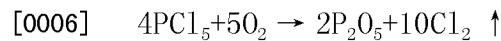
背景技术：

[0002] 扩散是太阳能电池制作过程中的关键工序，目的是利用三氯氧磷(POCl_3)在高温下进行磷原子的掺杂制作PN结，其过程如下：

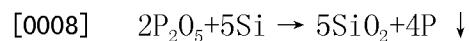
[0003] POCl_3 在高温下($>600^\circ\text{C}$)分解生成五氯化磷(PCl_5)和五氧化二磷(P_2O_5)，其反应式如下：



[0005] 在扩散气氛中常常通有一定量的氧气，可使生成的 PCl_5 进一步分解，使五氯化磷氧化成 P_2O_5 ，从而可以得到更多的磷原子沉积在硅片表面上。另外也可避免 PCl_3 对硅片的腐蚀作用，可以改善硅片表面，反应式如下：



[0007] 生成的 P_2O_5 成在扩散温度下继续与硅反应得到磷原子，其反应式如下



[0009] 至此扩散过程结束，在距离硅片表面0.3-0.5um的厚度内掺杂进磷原子，该层称为扩散层，同时在硅片表面上形成一层含有磷元素的 SiO_2 ，称为磷硅玻璃。

[0010] 对扩散工序的监控方法是抽测扩散后硅片的方块电阻值，如果超出预先设定的范围，则属于次品。因方块电阻值受源瓶温度、炉管温度、源瓶内三氯氧磷液面高度、炉管内酸排量等诸多因素的影响，所以方块电阻值不合格的情况比较频繁。该类次品如果继续做成电池则会产生大量的低效电池片。

[0011] 目前对扩散后硅片次品的返工处理是这样的：方块电阻值过大的硅片重新放入扩散炉内进行二次扩散，但这种方法较难控制方块电阻值，容易产生多次返工，既影响产量又影响电池合格率。方块电阻值过小的无较好处理办法，一般直接报废或者做成电池，但是直接报废会增加生产成本，直接做成电池将产生大量的低效电池片，也会导致电池合格率降低。

发明内容：

[0012] 本发明针对现有技术的上述不足，提供一种容易控制方块电阻值、无需多次返工，能降低生产成本，提高电池合格率的扩散后单晶硅片次品返工方法。

[0013] 为了解决上述技术问题，本发明采用的技术方案为：一种扩散后单晶硅片次品返工方法，包括以下步骤：

[0014] (1)将扩散后的次品硅片放入氢氟酸溶液中浸泡4~10min，去除扩散过程中形成的磷硅玻璃层，其中氢氟酸溶液中氢氟酸与水的体积比为1:4~10；

[0015] (2)将步骤(1)浸泡后的硅片用去离子水清洗，去除硅片表面残留的氢氟酸；

- [0016] (3) 将步骤(2)清洗后的硅片放入 NaOH 溶液中浸泡 2min ~ 5min, 其中 NaOH 溶液的质量百分比浓度为 2% ~ 10%, NaOH 溶液的温度为 60℃ ~ 80℃, 以去除硅的表面扩散层;
- [0017] (4) 将步骤(3)浸泡后的硅片用 H₂O₂ 溶液将硅片清洗干净, H₂O₂ 溶液中 H₂O₂ 与水的体积比为 1 : 4 ~ 10。
- [0018] 作为优选, 步骤(1)氢氟酸溶液中 HF 与水的体积比为 1:5。
- [0019] 作为优选, 步骤(1)中的浸泡时间为 6min。
- [0020] 作为优选, 步骤(3)中 NaOH 溶液的质量浓度为 5%。
- [0021] 作为优选, 步骤(3)中 NaOH 溶液的温度为 80℃。
- [0022] 作为优选, 步骤(3)中浸泡时间为 2.5min。
- [0023] 作为优选, 步骤(4)H₂O₂ 溶液中的 H₂O₂ 与水的体积比为 1:6。
- [0024] 本发明的优点和有益效果:采用本发明的方法,可以使得硅片表面的磷硅玻璃层和扩散层被完全去除,与正常硅片无差异,从而可以重新制作电池片,降低了生产成本,提高了电池合格率。

附图说明

- [0025] 图 1 为扩散前硅片结构示意图。
- [0026] 图 2 为扩散后硅片结构示意图。
- [0027] 其中:1. 硅片, 2. 扩散层, 3. 磷硅玻璃。

具体实施方式

- [0028] 下面通过实施例进一步详细描述本发明,但本发明不仅仅局限于以下实施例。
- [0029] 实施例 1
- [0030] 预先配置好 HF 溶液,其中 HF 与水的体积比为 1:5;然后配置浓度为 5% 的 NaOH 溶液并加热至 80℃,最后配置 H₂O₂ 溶液,其中 H₂O₂ 与水的体积比为 1:6。
- [0031] 第一步:将扩散后方块电阻异常的单晶硅片次品(如图 2 所示,扩散后的硅片次品结构:包括硅片 1、扩散层 2 和磷硅玻璃 3)放入 HF 溶液中浸泡 6min。
- [0032] 第二步:将单晶硅片放入去离子水的水槽中浸泡,用去离子水将硅片上残留的 HF 溶液清洗干净,测试水质,直至 pH 为中性。
- [0033] 第三步:将清洗过后的硅片取出放入 NaOH 溶液中,浸泡 2.5min,将表面的扩散层去除。
- [0034] 第四步:将硅片置于 H₂O₂ 溶液中,去除表面杂质及可能存在的金属离子。
- [0035] 清洗干净的硅片经过干燥后(结构如图 1 所示,仅有一层硅片 1 结构),从电池制作的第一道工序开始重新制作电池。
- [0036] 实施例 2
- [0037] 预先配置好 HF 溶液,其中 HF 与水的体积比为 1:6;然后配置浓度为 6% 的 NaOH 溶液并加热至 70℃,最后配置 H₂O₂ 溶液,其中 H₂O₂ 与水的体积比为 1:6。
- [0038] 第一步:将扩散后方块电阻异常的单晶硅片次品放入 HF 溶液中浸泡 6min。
- [0039] 第二步:将单晶硅片放入去离子水的水槽中浸泡,用去离子水将硅片上残留的 HF 溶液清洗干净,测试水质,直至 pH 为中性。

[0040] 第三步 : 将清洗过后的硅片取出放入 NaOH 溶液中, 浸泡 3min, 将表面的扩散层去除。

[0041] 第四步 : 将硅片置于 H₂O₂ 溶液将中, 去除表面杂物及可能存在的金属离子。

[0042] 清洗干净的硅片经过干燥后, 从电池制作的第一道工序开始重新制作电池。

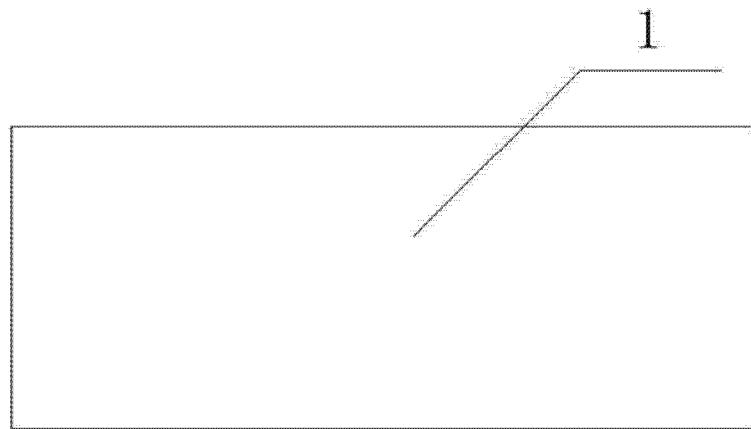


图 1

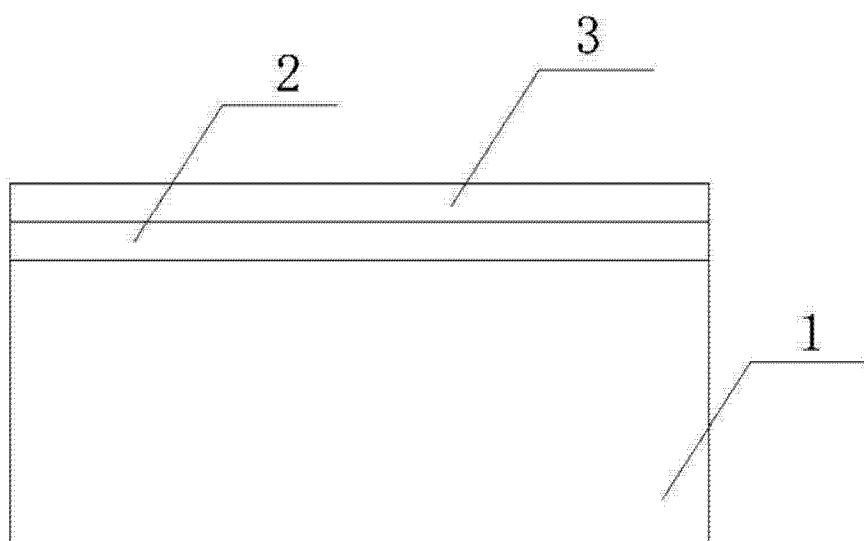


图 2